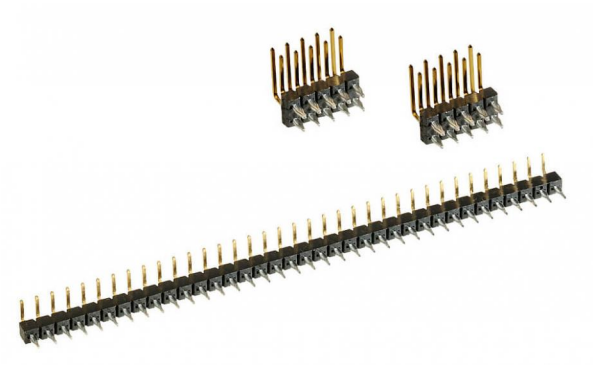
Produktdatenblatt

VarPol Stiftleiste 2-reihig, Art. Nr. 982-nn010-b1



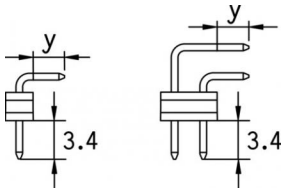


Abbildung ähnlich

Rechtwinklig

Einpresstechnik

- Länge Steckseite (Y) = 2.8 mm
- Einpresstechnik
- Anschlusslänge 3.4 mm
- Polzahl 2 - 108
- 2-reihig
- b in Artikelnummer definiert die Gütestufe der Steckseite

» zum Produkt auf www.ept.de

» zur Produktgruppe Varpol connectors

ept GmbH | Bergwerkstr. 50 | 86971 Peiting | Tel. +49 (0) 8861 / 25 01 0 | Fax +49 (0) 8861 / 55 07 | sales@ept.de | **www.ept.de**

Technische Daten

Grundlagen

Anzahl Kontakte	2 - 108
Anschlusstechnik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	3.4 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft pro Kontakt	max. 0.9 N
Ziehkraft pro Kontakt	min 0.6 N

Elektrisch

Betriebsstrom	max. 1.9 A
Betriebsspannung	150 V
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	1.2 mm
Isolationswiderstand	$>10^6$ MΩ

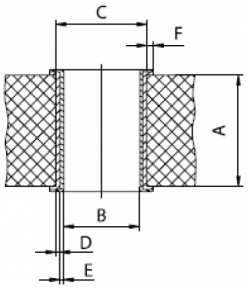
Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

ept GmbH | Bergwerkstr. 50 | 86971 Peiting | Tel. +49 (0) 8861 / 25 01 0 | Fax +49 (0) 8861 / 55 07 | sales@ept.de | **www.ept.de**

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
Nennloch	**Ø 1.0 mm**
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	**Ø 1.0 mm**
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	**Ø 1.0 mm**
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	**Ø 1.0 mm**
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

ept GmbH | Bergwerkstr. 50 | 86971 Peiting | Tel. +49 (0) 8861 / 25 01 0 | Fax +49 (0) 8861 / 55 07 | sales@ept.de | **www.ept.de**

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

» PDF

ept GmbH | Bergwerkstr. 50 | 86971 Peiting | Tel. +49 (0) 8861 / 25 01 0 | Fax +49 (0) 8861 / 55 07 | sales@ept.de | **www.ept.de**